

(19) 대한민국특허청(KR)  
(12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl.<sup>6</sup>  
H01L 21/321

(11) 공개번호 특1997-0052967  
(43) 공개일자 1997년07월29일

(21) 출원번호	특1996-0067571
(22) 출원일자	1996년12월18일
(30) 우선권주장	7-353987 1995년12월28일 일본(JP)
(71) 출원인	신에쓰 한도타이 가부시카가이사 와다 다다시 일본국 도쿄도 치요다꾸 마루노우치 1-초메 4-2
(72) 발명자	하세가와 후미히코 일본국 후쿠시마켄 니시-시라카와-군 니시고-무라 오히자-오다꾸라 아자-오히라 250-9 고후-료 206 고바야시 마코도 일본국 후쿠시마켄 니시-시라카와-군 니시고-무라 오히자-오다꾸라 아자-하라나가 198-9 팬-하이쯔 에프-101 스즈끼 후미오 일본국 후쿠시마-켄 니시-시라카와-군 타이신-무라 오히자-구 마도 아자-고와따끼 18-1
(74) 대리인	손원, 전준향

**심사청구 : 있음**

**(54) 웨이퍼 연마장치**

**요약**

평탄성이 우수한 웨이퍼를 안정적으로 얻을 수 있는 웨이퍼 연마장치를 제공한다.

연마포가 제공된 정반과, 그 정반 중심에서 떨어진 위치의 상방에 설한 연마헤드와, 그 연마헤드의 하측에 설치되는 플레이트를 갖고, 상기 플레이트에는 웨이퍼를 압압하기 위한 백킹 패드가 설해짐과 동시에, 복수개의 상기 웨이퍼를 담지 가능하게 구성된 케리어가 당해 플레이트에 대하여 회전자재로 되게 설치되며, 상기 플레이트에 대하여 상기 웨이퍼를 자전시키면서 공전시킴에 의해 당해 웨이퍼의 연마를 행하도록 구성시킨 것을 특징으로 한다.

**대표도**

**도1**

**명세서**

[발명의 명칭]

웨이퍼 연마장치

[도면의 간단한 설명]

제1도는 본 발명의 일실시예에 의한 연마장치의 주요부에 대한 정면도.

본 내용은 요부공개 건이므로 전문내용을 수록하지 않았음

**(57) 청구의 범위**

**청구항 1**

연마포가 제공된 정반(定盤)과, 그 정반 중심으로부터 떨어진 위치의 상방에 설해진 연마헤드와, 그 연마헤드의 하측에 설치되는 플레이트를 갖고, 상기 플레이트에는 웨이퍼를 압압하기 위한 백킹 패드가 설치됨과 동시에, 복수개의 상기 웨이퍼를 담지 가능하게 구성된 케리어가 당해 플레이트에 대하여 회전자재로 설해지며, 상기 플레이트에 대하여 상기 웨이퍼를 자전시키면서 공전시킴에 의해 당해 웨이퍼의 연마를 행하도록 구성한 것을 특징으로 하는 웨이퍼 연마장치.

